

# EIGNUNGSMATRIX UNSERER OBERFLÄCHEN

	CHEM. NI/AU ENIG	CHEM. NI/PD/AU ENEPIG	CHEM. PD/AU EPIG	DIRECT GOLD DIG	GALV. NI/HARTGOLD	GALV. NI/FEINGOLD	CHEM. ZINN	HAL BLEIFREI	HAL SNPB	CHEM. SILBER
Beschreibung	Reduktiv Nickel/Immersion Gold	Reduktiv Nickel/Reduktiv Palladium/Immersion Gold	Reduktiv Palladium/Teilreduktives Gold	Teilreduktives Gold	Steckkontakte			Hot Air Leveling (Heißluftezinnung)	Hot Air Leveling (Heißluftezinnung)	
Layer und Schichtdicke	Ni: 4-7µm Au: 0,05-0,1µm	Ni: 4-7µm Pd: 0,1-0,3µm Au: 0,03-0,3µm	Pd: 0,1-0,3µm Au: 0,1-0,3µm	Au: 0,2-0,3µm	Ni: >4µm Au: 0,8-3µm	Ni: >4µm Au: 0,2-10µm	Sn: 1µm	SnCuNi-Leg 1-50µm	SnPb-Leg 1-50µm	Ag: 0,2µm
Löten	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲
Bonden Al-Draht	▲	▲	▲	▲	✘	▲	✘	✘	✘	▲
Bonden Au-Draht	▼	▲	▲	▲	✘	▲	✘	✘	✘	▲
Hochfrequenz	●	●	▲	▲	●	▲	●	●	●	▲
Lagerfähigkeit	>12 MONATE	>12 MONATE	>12 MONATE	>12 MONATE	>12 MONATE	>12 MONATE	6 MONATE	>12 MONATE	>12 MONATE	6 MONATE
Einpresstechnik	●	●	▲	▲	●	●	▲	▲	▲	●
Korrosionsbeständigkeit	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	●
Preis	●	●	▼	▼	●	●	▲	▲	▲	▲
RoHS	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	✘	▲

▲-uneingeschränkt    ▲-gut durchführbar    ●-mit Einschränkung    ▼-stark limitiert    ✘-ungeeignet